

**关于天津金海通半导体设备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件的审核问询函回复的专项说明**

容诚专字[2026]361Z0644号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于天津金海通半导体设备股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

申请文件的审核问询函回复的专项说明

容诚专字[2026]361Z0644 号

上海证券交易所：

根据贵所 2026 年 8 月 7 日印发的《关于天津金海通半导体设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕244 号）（以下简称“问询函”）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我们”或“申报会计师”）对问询中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现做专项说明如下：

目录

问题 1.关于本次募投项目	3
问题 2.关于公司业务与经营情况.....	18
问题 3.关于其它.....	50

问题 1.关于本次募投项目

根据申请材料，1）公司本次募集资金总额不超过 85,000 万元，拟用于“上海澜博半导体设备制造中心建设项目”“半导体先进装备技术研发项目”及补充流动资金。2）前次募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”处于建设期，“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”存在延期、终止的情形，部分剩余募集资金暂未确定投向。3）“上海澜博半导体设备制造中心建设项目”内部收益率（所得税后）为 16.88%，投资回收期（所得税后）为 6.81 年（含建设期）。

请发行人说明：

（1）本次募投项目所涉产品是否属于现有业务，所涉新产品与现有业务的相关性、协同性，是否已完成中试或达到同等状态，相关产品的技术、生产程序是否具有可行性，相关技术难点及公司研发和储备情况，公司是否具备量产能力，客户验证情况及产业化进展情况，结合上述内容说明本次募投项目实施是否存在重大不确定性，是否符合募集资金投向主业的要求，相关风险提示是否充分；（2）公司延期、变更前次募投项目的原因及合理性，前次募投项目已投入或建设情况、目前经营或研发活动开展情况，是否存在产能消化风险；结合前次募投项目投入进度及实施进展未达预期的具体原因，说明相关因素是否影响本次募投项目实施，前次剩余募集资金拟投入的具体领域等，本次募投项目实施是否具有必要性及紧迫性；（3）结合本次募投项目产品的市场空间、竞争格局，本次募投项目产品对应的在手订单，以及公司现有产能利用率及产销情况，目前各生产基地的产能情况及未来产能规划、预期交付进度等，说明本次募投项目新增产能规划的合理性及消化措施，是否存在产能消化风险；（4）结合公司现有各研发基地及设备的使用情况、人均研发面积、同行业可比公司情况、辐射区域布局规划等，说明“半导体先进装备技术研发项目”实施的必要性，分析对公司前募“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”及现有主营业务的具体影响；（5）本次各募投项目的具体构成和测算依据，相关单价或单位产能投资比与公司类似项目或同行业公司可比项目是否存在较大差异；对比租赁和新建厂房成本，说明本次募投项目实施的商业合理性；结合项目建设期、产能利用率、产销情况、产品价格

变动趋势、成本变化情况等，说明“上海澜博半导体设备制造中心建设项目”内部收益率、投资回收期等指标测算是否谨慎、合理；量化分析本次各募投项目建成后新增折旧摊销以及对公司经营业绩的具体影响，相关风险提示是否充分；（6）结合公司业务规模、业务增长、现金流、资产负债结构等情况，说明本次补充流动资金规模的合理性。

请保荐机构进行核查并发表明确意见。请保荐机构及申报会计师根据《证券期货法律适用意见第18号》第5条、《监管规则适用指引—发行类第7号》第5条对问题（5）（6）进行核查并发表明确意见。

【发行人说明】

五、本次各募投项目的具体构成和测算依据，相关单价或单位产能投资比与公司类似项目或同行业公司可比项目是否存在较大差异；对比租赁和新建厂房成本，说明本次募投项目实施的商业合理性；结合项目建设期、产能利用率、产销情况、产品价格变动趋势、成本变化情况等，说明“上海澜博半导体设备制造中心建设项目”内部收益率、投资回收期等指标测算是否谨慎、合理；量化分析本次各募投项目建成后新增折旧摊销以及对公司经营业绩的具体影响，相关风险提示是否充分；

（一）本次各募投项目的具体构成和测算依据，相关单价或单位产能投资比与公司类似项目或同行业公司可比项目是否存在较大差异；

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含 85,000.00 万元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		投资总额	募集资金投入金额
1	半导体先进装备智能制造及创新研发项目	上海澜博半导体设备制造中心建设项目	40,000.00	40,000.00
		半导体先进装备技术研发项目	32,000.00	32,000.00
	小计		72,000.00	72,000.00
2	补充流动资金		13,000.00	13,000.00
合计			85,000.00	85,000.00

1、本次各募投项目的具体构成和测算依据

(1) 上海澜博半导体设备制造中心建设项目

本项目总投资金额为 40,000.00 万元，具体构成如下：

投资项目	金额（万元）	投资比重
土地购置	5,194.75	12.99%
建筑工程	24,501.34	61.25%
设备购置	5,397.20	13.49%
基本预备费	350.93	0.88%
铺底流动资金	4,555.77	11.39%
总投资	40,000.00	100.00%

具体测算依据如下：

A、土地购置

土地购置面积（亩）	购置单价（万元/亩）	金额（万元）（含税）	地点	备注
30.00	168.03	5,194.75	上海青浦区华新镇 13B-06 地块	购置价格参考与政府签订合同价格及相应契税等测算

B、建设费用

建筑工程明细				
建筑名称	建筑面积（平方米，项）	建筑单价（万元/平方米，项）	金额（万元）	备注
装配车间	13,735.66	0.68	9,340.25	通过与专业第三方等机构进行调研，参考同类项目的造价结构、单位成本构成，结合当前建材市场价格波动、施工工艺升级，以及本次项目的具体配置差异，进行合理优化，最终确定本次项目单位造价预算
仓储车间	6,000.00	0.68	4,080.00	
小计	19,735.66		13,420.25	
其他配套区域	3,020.78	0.68	2,054.13	
研发综合楼	22,834.21	0.35	7,991.97	
门卫	77.76	0.45	34.99	
道路绿化供电等	1	1,000.00	1,000.00	
小计	25,933.75		11,081.09	
合计	45,669.41	-	24,501.34	

本项目工程建设费用与半导体设备行业上市公司类似项目单位工程建设费用对比情况如下：

公司名称	项目名称	建筑工程投资（万元）	规划建筑面积（平方米）	单位造价（万元/平方米）
精智达	半导体存储测试设备产业化智造项目	24,750.00	40,000.00	0.62

公司名称	项目名称	建筑工程投资 (万元)	规划建筑面积 (平方米)	单位造价 (万元/ 平方米)
中科飞测	上海高端半导体质量控制设备产业化项目	65,501.63	98,743.62	0.66
华兴源创	半导体 SIP 芯片测试设备生产项目	4,600.00	13,000	0.35
金海通	上海澜博半导体设备制造中心建设项目	24,501.34	45,669.41	0.54
	IPO 募投-半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	19,832.00	48,121.95	0.41

注：数据来源于上市公司公开披露文件，可比公司长川科技类似项目“转塔式分选机开发及产业化项目”、“探针台研发及产业化项目”不涉及新建厂房，故未列示比较。

由上表可见，本项目单位造价略高于 IPO 募投项目，略低于同行业公司相似项目，主要系不同项目的建设地点、建设内容、建设时间等均有差异，整体单位造价处于合理范围内，不存在较大差异。

C、设备购置

项目生产相关的软硬件设备采购数量主要系综合考虑公司本项目实际需要、现有生产设备情况等因素进行合理估算，价格测算依据主要系参考公司同类或相似设备历史采购价格或自建价格、供应商询价以及市场公开价格等因素进行合理估算。

D、基本预备费

本次募投项目中，上海澜博半导体设备制造中心建设项目的基本预备费系根据该项目建设费用投资额的 1%估算，合计 350.93 万元，主要用于项目建设期间发生的不可预见费用，为应对建设期间难以预料、有可能发生的工程费用预留资金。

E、铺底流动资金

结合公司 2024 年及 2025 年流动资产及流动负债周转情况，测算项目运营期需要新增流动资金为 34,444.60 万元，取其 13.23%列为项目铺底资金，项目铺底流动资金为 4,555.77 万元，本项目铺底流动资金主要用于项目投产前的购买原材料、支付员工工资及其他经营费用等周转，具有合理性。

(2) 半导体先进装备技术研发项目的具体构成和测算依据

项目总投资金额为 32,000.00 万元，具体构成如下：

序号	投资项目	金额（万元）	投资占比
1	装修工程	11,961.97	37.38%
2	设备购置	13,494.00	42.17%
3	人员费用	6,242.00	19.51%
4	基本预备费	302.03	0.94%
5	合计	32,000.00	100.00%

具体测算依据如下：

A、装修费用

研发场地装修工程				备注
项目	建筑面积（m²）	装修单价（万元/m²）	金额（万元）	
综合实验室	8,500.00	0.65	5,525.00	通过与专业第三方等机构进行调研，参考同类项目的造价结构、单位成本构成，结合当前建材市场价格波动、施工工艺升级，以及本次项目的具体配置差异，进行合理优化，最终确定本次项目单位造价预算
办公室	5,834.21	0.35	2,041.97	
洁净试验车间	3,500.00	0.72	2,520.00	
试制车间	2,500.00	0.40	1,000.00	
配套功能区	2,500.00	0.35	875.00	
合计	22,834.21	--	11,961.97	

B、设备购置

项目研发相关的软硬件设备采购数量主要系综合考虑公司本项目实际需要、现有研发设备情况等因素进行合理估算，价格测算依据主要系参考公司同类或相似设备历史采购价格、供应商询价以及市场公开价格等因素进行合理估算。

本项目设备购置合计 13,494.00 万元，其中硬件投资金额为 8,798.00 万元，软件投资金额为 4,696.00 万元。

序号	投资项目	金额（万元）	投资占比
1	装修工程	8,798.00	65.20%
2	设备购置	4,696.00	34.80%
合计		13,494.00	100.00%

C、人员费用

在本次半导体先进制造装备技术研发项目中，研发人员工资根据项目各类型人员需求数量和公司对应研发人员的平均薪酬水平确定，测算具备合理性。

D、基本预备费

半导体先进装备技术研发项目的基本预备费根据该项目投资总额的 0.94% 估算，合计 302.03 万元，主要用于项目建设期间发生的不可预见费用，为应对建设期间难以预料、有可能发生的工程费用预留资金。

2、相关单价或单位产能投资比与公司类似项目或同行业公司可比项目是否存在较大差异。

公司募投项目建筑工程单位造价，与公司类似项目或同行业公司可比项目对比如下：

公司名称	项目名称	建筑工程投资 (万元)	规划建筑面积 (平米)	单位造价 (万元/ 平米)
精智达	半导体存储测试设备产业化智造项目	24,750.00	40,000.00	0.62
中科飞测	上海高端半导体质量控制设备产业化项目	65,501.63	98,743.62	0.66
华兴源创	半导体 SIP 芯片测试设备生产项目	4,600.00	13,000	0.35
金海通	上海澜博半导体设备制造中心建设项目	24,501.34	45,669.41	0.54
	IPO 募投-半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	19,832.00	48,121.95	0.41

注：数据来源于上市公司公开披露文件，可比公司长川科技类似项目“转塔式分选机开发及产业化项目”、“探针台研发及产业化项目”不涉及新建厂房，故未列示比较

由上表可见，本项目单位造价略高于 IPO 募投项目，略低于同行业公司相似项目，主要系不同项目的建设地点、建设内容、建设时间等均有差异，整体单位造价处于合理范围内，不存在较大差异。

公司募投项目单位产能投资比，与公司类似项目或同行业公司可比项目对比如下：

公司	可比项目	投资金额 (万元)	新增产能 (台)	单位产能投资额 (万元/台)
		A	B	C=A/B
长川科技	探针台研发及产业化项目	30,001.04	485	61.85
长川科技	转塔式分选机开发及产业化项目	14,171.07	260	54.50
精智达	半导体存储测试设备产业化智造项目	44,096.00	未披露	未披露
中科飞测	上海高端半导体质量控制设备产业化项目	84,572.98	78	1,084.27

公司	可比项目	投资金额 (万元)	新增产能 (台)	单位产能投资额 (万元/台)
		A	B	C=A/B
华兴源创	半导体 SIP 芯片测试设备生产项目	21,000.00	140	150.00
金海通	IPO 募投项目-半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	43,615.04	500	87.23
	本次募投项目-上海澜博半导体设备制造中心建设项目	40,000.00	340	117.65

注：数据来源于上市公司公开披露文件

半导体设备领域上市公司募投项目单位产能投资比情况，因各项目产品形态、生产标准、技术要求、生产流程等方面不同，从而对设备、场地的要求参数不同，导致各项目相关投资比存在一定差别：

其中，长川科技的两个可比项目单位产能投资额相对较低，主要系相关项目主要采用租赁或自有厂房实施，不涉及新建厂房所致。中科飞测单位产能投资额较高，主要系其产品系前道半导体设备，单位成本较大所致。

总体而言，公司本次募投和前次 IPO 募投的单位产能投资额，与可比公司相关项目整体在同一范围，不存在较大差异，具备合理性。

（二）对比租赁和新建厂房成本，说明本次募投项目实施的商业合理性；

目前公司在上海的生产、研发及办公场所均通过租赁方式取得，现有厂区面积、空间布局及设施负荷已全面饱和，空间、电力、干燥气供应等均无进一步提升空间，公司通过生产流程优化、工时效率提升、跨部门厂务资源分时分配等方式，实现产能 30 台/月，年产能 360 台，2025 年产能利用率接近 200%，远不能满足订单增长需求。

针对产能扩张需求，公司客观上面临两种路径选择：在青浦及周边长三角区域租赁标准化厂房扩产，或购地自建专业化生产基地。租赁和新建厂房成本对比如下：

本次募投项目所在地上海市青浦区同类厂房租赁单价 1.194 元/平米/天，45,669.41 平方米厂房年租金为 1,990.32 万元，在不考虑租金上涨的情况下，20 年租金合计 39,806.37 万元；叠加初始装修成本（按高端厂房标准 1000 元/平米测算）4,566.94 万元，20 年总成本达 44,373.31 万元，高于本次募投买地自建成

本即本次募投项目“上海澜博半导体设备制造中心建设项目”总投资金额40,000.00万元。

从全周期成本对比来看，自建厂房较租赁模式的成本优势贯穿项目生命周期，无其他额外投资。买地自建厂房情况下，无后续持续租金支出，固定资产可享受折旧抵扣、资产增值等附加价值。租赁厂房需承担租金波动风险、装修改造受限风险（如现有租赁厂房无法满足承重、电力、洁净空间需求），而自建厂房可更好满足公司生产需求，避免后续隐性支出。

综上，本次募投项目通过买地自建实施相比租赁厂房实施优势明显，具备商业合理性。

（三）结合项目建设期、产能利用率、产销情况、产品价格变动趋势、成本变化情况等，说明“上海澜博半导体设备制造中心建设项目”内部收益率、投资回收期等指标测算是否谨慎、合理；

本项目建设期3年，完全达产后预计年均营业收入42,361.55万元，年均净利润8,345.74万元。本项目预计毛利率为48.06%，项目内部收益率（所得税后）为16.88%，投资回收期（所得税后）为6.81年（含建设期），具有良好的经济效益。

1、项目建设期安排

本次项目建设期为3年，含前期方案规划设计、建筑工程、土建工程竣工、设备订货采购、设备安装调试、项目验收及投产等阶段。投产后第3年完全达产。

项目	第一年（T1）				第二年（T2）				第三年（T3）			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
前期方案规划设计												
建筑工程												
土建工程竣工												
设备订货采购												
设备安装调试												
项目验收及投产												

项目建设期符合项目建设实际需求，具备合理性。

2、产能利用率、产销情况

报告期各期，公司产能、产量、销量情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
产能（台）	202	360	360	360
产量（台）	491	677	308	361
销量（台）	468	539	333	317
产能利用率	243.07%	188.06%	85.56%	100.28%
产销率	95.32%	79.62%	108.12%	87.81%

目前公司在上海的生产、研发及办公场所均通过租赁方式取得，现有厂区面积、空间布局及设施负荷已全面饱和，空间、电力、干燥气供应等均无进一步提升空间，公司通过生产流程优化、工时效率提升、跨部门厂务资源分时分配等方式，实现产能 30 台/月，年产能 360 台，2025 年产能利用率接近 200%，2026 年 1-6 月产能利用率超过 200%，现有产能远不能满足订单增长需求。

（1）产能利用率

本项目建成并达产后预计可实现新增年产能 340 台，结合项目建设周期及达产进度安排，项目于 T3 年达产 30%，T4 年达产 80%，T5 年开始完全达产，达到 100%产能利用率。本项目建成后，公司可以充分利用现有的生产技术，在本次募投项目建成后进行生产，具备较快实现本项目稳定量产的能力，因此对本项目的产能利用率预计具备合理性。

（2）产销情况

本次募投项目假设产销率为 100%，即根据各年度产量预测当年销量。本次募投项目产量和销量系根据下游市场需求、市场发展趋势、订单情况及公司自身实际经营情况进行测算，产销情况测算具有合理性。在销量方面，全球及中国半导体测试分选机市场正处于高速增长期，国产替代空间巨大，本次募投项目产品市场空间广阔，公司的产能消化措施清晰可行，产能消化能力较强。报告期内，公司产能利用率及产销率均处于高位，公司拥有的在手订单充沛，因此，本次募投项目经营期间产销率设置为 100%，具备合理性。

综上所述，本次募投项目产能利用率、产销情况的预测具有合理性。

3、产品价格变动趋势、成本变化情况

（1）产品价格变动趋势

本次募投项目产品价格系公司参考同类产品历史价格、下游市场需求及行业内产品价格变动趋势等因素综合确定。

基于谨慎性原则，假设计算期内产品价格存在 2%-3%的降幅预测收入。

根据上述假设，本项目完全达产后预计可实现年均营业收入 42,361.55 万元。相关测算具备谨慎性及合理性。

（2）成本变化情况

公司参照历史成本、合理的毛利率水平等因素进行营业成本的测算。

项目营业成本包括直接材料、直接人工、制造费用以及折旧摊销费用等。直接材料、直接人工、制造费用主要综合考虑公司既往生产情况及本次募投项目实际情况合理估算，折旧摊销费用主要为本次募投项目转固后折旧摊销产生，具有谨慎性和合理性。

根据测算，本次募投项目达产后年均毛利率为 48.06%。报告期内，公司毛利率分别为 47.55%、47.46%、52.21%和 53.55%。报告期内，公司毛利率总体较为稳定，2025 年以来稍有上升。公司在测算毛利率时考虑公司历史成本波动、单价波动等因素，对募投项目产品毛利率的影响，测算具有谨慎性及合理性。

4、综合效益测算及同行业对比

本项目建设期 3 年，完全达产后预计可实现年均营业收入 42,361.55 万元，年均净利润 8,345.74 万元，项目内部收益率（所得税后）为 16.88%，投资回收期（所得税后，含建设期）为 6.81 年。

同行业同类或类似项目的毛利率水平、效益情况对比如下：

公司	可比项目	毛利率	税后内部收益率	税后投资回收期（含建设期）
长川科技	探针台研发及产业化项目	50.00%	12.00%	6.53 年
长川科技	转塔式分选机开发及产业化项目	34.07%	12.52%	未披露
精智达	半导体存储测试设备产业化智造项目	未披露	18.22%	8.83 年
中科飞测	上海高端半导体质量控制设备产业化项目	46.41%	13.57%	8.40 年
华兴源创	半导体 SIP 芯片测试设备生产项目	45.12%	23.77%	6.98 年
金海通	IPO 募投项目-半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	60.15%	19.75%	7.95 年

公司	可比项目	毛利率	税后内部收益率	税后投资回收期（含建设期）
	本次募投项目-上海澜博半导体设备制造中心建设项目	48.06%	16.88%	6.81 年

由上表可知，公司本次募投项目毛利率水平、内部收益率和投资回收期与同行业类似项目基本处于同一范围，具有合理性。

综上，公司本次募投项目“上海澜博半导体设备制造中心建设项目”内部收益率、投资回收期等指标测算具备谨慎性、合理性。

（四）量化分析本次各募投项目建成后新增折旧摊销以及对公司经营业绩的具体影响，相关风险提示是否充分；

本次募投项目达产后，新增折旧摊销对发行人业绩的影响分析如下：

单位：万元

达产后对业绩影响	达产年金额
预计折旧摊销费用	3,715.28
预计新增年均营业收入	42,361.55
预计年均净利润	8,345.74

根据项目预期效益测算数据，达产后募投项目每年新增折旧摊销金额为 261.82 万元~3,715.28 万元。达产后新增年均营业收入为 42,361.55 万元，达产后新增年均净利润为 8,345.74 万元，项目收入足够覆盖项目新增折旧摊销，并可实现较好的净利润表现；新增折旧摊销费用对业绩的影响较小，对公司未来经营业绩不构成重大不利影响。未来，随着募投项目的建成并达到稳定的运营状态，募投项目新增业务净利润将大幅提高。

公司已在募集说明书“第三节”之“其他风险”进行了风险提示。具体如下：

“

发行人此次募投项目“上海澜博半导体设备制造中心建设项目”和“半导体先进装备技术研发项目”将新增固定资产和无形资产投资。两个项目实施后，公司生产模式无重大变化，资产规模将有所提高，如项目实际效益低于预期，或者发行人未来运营效率不达预期，则新增折旧与摊销将对公司经营业绩带来不利影响。同时，本次募投项目需要一定的建设期，难以在短期内对公司盈利产生显著的贡献。因此，发行人存在发行后净资产收益率在短期内下降的风险。

”

六、结合公司业务规模、业务增长、现金流、资产负债结构等情况，说明本次补充流动资金规模的合理性；

公司综合考虑了业务发展、经营战略、财务状况、资产负债结构以及市场融资环境等自身和外部条件，拟将本次募集资金中的 13,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务健康良性发展，实现战略发展目标。结合公司业务规模、业务增长、现金流、资产负债结构等情况，公司本次补充流动资金规模 1.3 亿元具备充分合理性。具体分析如下：

（一）公司业务规模快速增长，具备明确的补充流动资金的增量需求

公司深耕集成电路测试分选机领域，主要产品测试分选机销往中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。近年来，AI 算力与先进封装驱动高端测试需求爆发。当前全球半导体行业正处于 AI 算力爆发与先进封装普及双重驱动叠加的上行周期，芯片复杂度、集成度与可靠性要求持续提升，推动封测环节资本开支大幅增长，直接带动高端测试分选设备需求高速增长。在高速增长背景下，公司日常运营需要流动资金作为坚实基础。

报告期内，公司营业收入及其变动情况如下：

单位：万元、%

项目	2026 年 1-6 月	2025 年		2024 年		2023 年度
	数额	数额	变动	数额	变动	数额
营业收入	60,071.36	69,817.60	71.68%	40,666.63	17.12%	34,723.45

报告期各期，公司营业收入分别为 34,723.45 万元、40,666.63 万元、69,817.60 万元和 60,071.36 万元，2024 年、2025 年，公司营业收入增长率分别为 17.12%、71.68%，营业收入规模呈现快速上升趋势，2026 年 1-6 月公司营业收入已经达到 2025 年全年的 86.04%，保持高速增长。业务规模的快速扩张直接带动营运资金占用量的大幅增长，公司需要匹配的流动资金规模也随之快速上升。

公司以 2025 年为基期，根据公司营业收入历史增长情况、近期经营性资产、经营性负债占营业收入的比例为基准，随着业务快速增长，在不考虑本次募投项目资金需求情况下，未来三年公司经营性营运资金缺口将达 7.28 亿元，具体如

下：

单位：万元

项目	基期	占营业收入的比例	营收增长率 30.00%		
	2025 年		2026 年 E	2027 年 E	2028 年 E
营业收入	69,817.60	100.00%	90,762.88	117,991.74	153,389.27
经营性流动资产合计	101,537.23	145.43%	131,998.40	171,597.92	223,077.29
经营性流动负债合计	40,738.50	58.35%	52,960.05	68,848.07	89,502.48
经营性营运资金金额	60,798.73	87.08%	79,038.35	102,749.85	133,574.81
流动资金缺口			18,239.62	23,711.50	30,824.96
未来三年流动资金缺口（万元）			72,776.08		

除增量的经营性营运资金缺口外，新增产能落地还需要配套相应的备货、生产所需周转资金等，进一步推高流动资金需求。本次募集资金中 1.3 亿元用于补充流动资金，能够有效满足公司业务增长的节奏及补充流动资金的需求，为产能爬坡提供充足的资金保障。

（二）业务规模扩张背景下，公司现金流承压，补充流动资金具有必要性及紧迫性

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-4,836.13 万元、5,898.61 万元、12,780.95 万元及 5,781.74 万元，报告期各期，公司净利润分别为 8,479.41 万元、7,848.15 万元、17,652.53 万元和 17,117.46 万元。

在公司业务规模快速扩张背景下，公司营业收入高速增长，导致了经营性应收的增长，同时公司为满足客户增长的需求，通过提前生产备货等手段导致公司存货的增加。

公司经营活动现金流入主要来自销售商品、提供劳务收到的现金，经营活动现金流出主要来自购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金等。

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月 /2026 年 6 月末	2025 年度 /年末	2024 年度 /年末	2023 年度 /年末
经营活动产生的现金流量净额	5,781.74	12,780.95	5,898.61	-4,836.13

综上，公司仅靠现有经营活动现金流，无法充分覆盖公司在原材料采购、生产备货及研发投入等业务规模扩张、未来业务扩张、日常运营周转等持续性的资

金需求。本次再融资部分募集资金用于补充流动资金，可进一步优化公司资金结构、增强抗风险能力，并为主营业务的持续稳定发展提供保障。

（三）经营性资产占比较高，产能扩张将进一步放大流动资金需求

报告期各期末，随着公司经营快速发展，公司应收账款、存货等经营性资产快速增加，公司货币资金余额逐渐降低。公司资产负债结构情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
流动资产	188,120.88	158,833.46	121,458.14	136,448.53
其中：货币资金	33,081.35	42,326.36	53,368.39	58,210.51
应收账款	72,727.66	52,141.01	34,222.55	24,397.52
存货	55,391.52	41,264.06	29,286.30	33,422.13
非流动资产	75,708.64	56,131.75	38,398.42	22,049.79
资产合计	263,829.53	214,965.22	159,856.56	158,498.32
流动负债	70,023.43	49,203.50	26,445.58	17,987.24
其中：应付票据	22,697.85	14,155.77	4,944.61	7,646.53
应付账款	36,965.02	25,779.80	11,039.56	6,542.14
非流动负债	4,132.96	4,332.41	1,787.71	625.52
负债合计	74,156.38	53,535.91	28,233.28	18,612.76
资产负债率	28.11%	24.90%	17.66%	11.74%

报告期各期末，发行人资产负债率分别为 11.74%、17.66%、24.90%和 28.11%，呈上升趋势。报告期各期末，公司日常经营过程中占用的流动资金金额持续增加。其中存货主要是公司满足下游客户需求的必要储备；应收账款则由下游行业结算模式决定，随着业务规模扩张，该类经营性资产规模将同步增长，持续放大流动资金占用需求。

综上，随着业务规模扩张，公司经营性资产规模将同步增长，持续放大流动资金占用需求。

综上，公司本次补充流动资金规模 1.3 亿元，在发行人业务规模不断扩大的背景下，可以对发行人业务发展提供有力支持，改善发行人的现金流状况及资产负债结构、提高抗风险能力，具备必要性与合理性。

【核查程序及核查意见】

一、核查程序

针对上述事项，申报会计师执行了以下核查程序：

1、查阅发行人同行业可比公司公开资料，对比本次募投项目相关单价或单位产能投资比与公司类似项目或同行业公司可比项目是否存在较大差异；查阅本次募投项目可行性研究报告，了解本次募投项目各项投资支出的具体构成、测算过程及测算依据，分析本次募投项目投资测算是否谨慎、合理；复核本次募投项目效益测算过程，分析本次募投项目产能利用率、产销情况、产品价格变动趋势、成本变化情况等关键指标测算的依据和合理性。

2、访谈发行人管理层，了解发行人报告期各期的业务发展情况。结合公司日常营运、经营性资产等，分析业务规模、业务增长情况、现金流状况、资产负债结构等变动趋势、本次补充流动资金规模的合理性；

二、核查意见

经核查，申报会计师认为：

1、本次募投项目各项投资测算依据充分，与发行人同类项目及同行业可比项目相比无显著不合理差异，具有公允性；本次募投项目新建厂房具备商业合理性；“上海澜博半导体设备制造中心建设项目”内部收益率、投资回收期等指标测算具备谨慎性、合理性；本次各募投项目建成后新增折旧摊销对公司经营业绩影响较小，对公司未来经营业绩不构成重大不利影响。未来，随着募投项目的建成并达到稳定的运营状态，募投项目新增业务净利润将大幅提高。公司已在募集说明书中进行了风险提示。

2、本次补充流动资金，系公司结合业务规模、业务增长情况、现金流状况、资产负债结构等情况审慎确定，可以对发行人业务发展提供有力支持，改善发行人的现金流状况及资产负债结构、提高抗风险能力，具备必要性与合理性。

问题 2.关于公司业务与经营情况

根据申报材料,1)报告期内,公司营业收入分别为 34,723.45 万元、40,666.63 万元、69,817.60 万元和 28,391.99 万元,归母净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为 6,946.60 万元、6,773.65 万元、17,104.86 万元和 8,098.98 万元。2)报告期内,公司境外营业收入分别为 6,325.93 万元、3,808.68 万元、8,593.14 万元和 5,737.80 万元。3)2025 年度,公司前五大客户销售占比 58.28%。4)报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 24,397.52 万元、34,222.55 万元、52,141.01 万元及 57,858.78 万元。5)报告期各期末,公司存货账面价值分别为 33,422.13 万元、29,286.30 万元、41,264.06 万元和 48,415.42 万元;6)报告期内,公司采用核心产品自主生产、部分成熟产品委托外协的方式进行生产加工。

请发行人说明:

(1) 结合各型号产品功能差异及供需情况、下游客户资本开支计划、在手订单情况、平均单价、成本费用等,说明公司报告期内营业收入、毛利率、净利润变动的原因,与可比公司变动趋势是否存在较大差异,业绩增长是否具有可持续性,公司是否能够持续满足可转债相关发行条件;(2) 公司报告期内海外业务的经营情况及主要客户合作情况、境内外业务毛利率的差异原因,报关数据、出口退税金额、信保数据等与公司外销业务规模是否匹配;近期国际贸易政策和税收政策变动是否影响已取得或预计取得的海外订单,相关风险提示是否充分;(3) 报告期公司前五大客户销售占比较高、对关联方销售金额上升的原因及合理性,相关交易定价的公允性;(4) 公司报告期内应收账款规模变动的原因;结合应收账款账龄、下游客户资信状况、预期信用损失情况、期后回款情况、单项计提内容及依据、同行业可比公司坏账计提情况等,说明公司坏账计提是否充分;(5) 公司报告期内存货规模变动的原因,长库龄存货的形成原因及订单覆盖情况,试用订单的转化情况,发出商品增长幅度较大的原因及合理性;结合存货库龄、周转率、期后结转情况、减值测试过程、可变现净值确定依据、同行业可比公司情况等,说明公司存货跌价准备计提是否充分;(6) 公司报告期内外协加工的业务模式及开展情况,相关外协费用与公司对应产品销量或收入的匹配情况;列示报告期内前五大外协供应商的名称、采购金额、合作起始年限等,说明相关方是否与公司存在关联关系或其他利益安排。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。

【发行人说明】

一、结合各型号产品功能差异及供需情况、下游客户资本开支计划、在手订单情况、平均单价、成本费用等，说明公司报告期内营业收入、毛利率、净利润变动的原因，与可比公司变动趋势是否存在较大差异，业绩增长是否具有可持续性，公司是否能够持续满足可转债相关发行条件；

（一）结合各型号产品功能差异及供需情况、下游客户资本开支计划、在手订单情况、平均单价、成本费用等，说明公司报告期内营业收入、毛利率、净利润变动的原因

报告期内，公司营业收入、毛利率、净利润情况如下所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年		2024 年		2023 年
	数额	数额	变动	数额	变动	数额
营业收入	60,071.36	69,817.60	71.68%	40,666.63	17.12%	34,723.45
毛利率	53.55%	52.21%	4.75%	47.46%	-0.09%	47.55%
净利润	17,117.46	17,652.53	124.93%	7,848.15	-7.44%	8,479.41

公司报告期内营业收入、毛利率、净利润变动受到各型号产品功能差异及供需情况、下游客户资本开支计划、在手订单情况、平均单价、成本费用等影响，具体如下：

1、产品功能差异及供需情况

报告期各期，EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列产品是公司测试分选机设备收入的主要来源。各主要型号功能差异与供需格局如下：

产品系列	核心功能及技术特点	供需格局	收入变动
EXCEED-6000 系列	1、可支持最多 8 工位并行测试； 2、可提供常温、高温（最高可达 155℃）测试环境； 3、UPH 最大可达 8,300 颗。	公司基础款机型，有着广泛的市场基础，报告期内整体呈现稳定增长趋势	2024 年收入金额稍有下降，2025 年、2026 年 1-6 月收入金额上升。

产品系列		核心功能及技术特点	供需格局	收入变动
EXCEED-8000 系列		1、可支持最多 16 工位并行测试；2、可提供常温、高温（最高可达 155℃）测试环境以及 ATC 主动控温功能；3、UPH 最大可达 13,500 颗。	公司中端主力机型，下游需求旺盛，报告期内整体呈现高速增长的趋势	2024 年收入金额稍有下降，2025 年、2026 年 1-6 月收入金额上升。
EXCEED-9000 系列	EXCEED-9032 系列	1、可支持最多 32 工位并行测试；2、可提供常温、高温（最高可达 155℃）测试环境以及 ATC 主动控温功能；3、UPH 最大可达 13,500 颗。	针对 AI 芯片、HBM、车规芯片等高端市场需求，下游需求旺盛，报告期内整体呈现高速增长的趋势	报告期内，EXCEED-9000 系列产品收入金额及收入占比均快速提升。
	EXCEED-9800 系列	1、可支持最多 16 工位并行测试；2、可提供低温（最低可达 -55℃）、常温、高温（最高可达 155℃）测试环境以及 ATC 主动控温功能；3、UPH 最大可达 9,300 颗。		

（1）从产品功能角度，公司阶梯式产品布局精准匹配下游需求，是业绩增长的产品基础

公司围绕芯片测试对工位并行度、温区覆盖、平台兼容性、运行稳定性的差异化需求，构建了覆盖全场景的阶梯式产品矩阵，各型号功能定位清晰、应用场景明确，是公司业绩增长的产品基础。

（2）从供需格局角度，公司下游需求持续增长，各产品均处于供不应求状态

报告期内，公司业绩快速增长，下游需求持续增长，各型号产品均处于供不应求的状态。当前，在 AI 算力与先进封装技术快速发展的双重驱动下，全球半导体行业已步入上行周期。芯片复杂度、集成度及可靠性要求的持续攀升，促使封测环节资本开支大幅扩张，从而带动高端测试分选设备需求高速增长。

2、下游客户资本开支计划、在手订单情况

公司下游客户广泛覆盖境内外主流封测厂商及 IDM 企业。随着半导体封装和测试设备领域需求的迅猛增长，下游客户的资本开支计划呈现扩张态势，为报告期内公司收入及利润的快速增长带来了良好的基础。

2025 年以来，AI 算力芯片、HBM、先进封装的爆发式增长，推动半导体封测环节资本开支开启上行通道。公司下游客户大规模扩产直接带动测试分选设备采购需求。

公司下游客户主要聚集于集成电路封装测试行业，该行业属于资本密集型行业，主要厂商为满足下游客户需求、提升市场占有率，需要根据自身发展阶段和业务规划，持续进行资本开支和产能建设。随着半导体下游市场的持续发展、先进封装需求的提升，行业内主要封测企业普遍持续推进产能扩充和工艺结构升级，投资规模较大，滚动实施资本开支具有较强的行业共性。近年来，主要下游客户“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”具体情况如下：

单位：亿元

下游公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
通富微电	62.11	45.54	51.25
长电科技	62.98	45.91	31.28
华天科技	61.46	50.01	37.14
伟测科技	29.46	14.83	12.22
甬矽电子	22.30	23.64	32.03

下游客户持续扩产，近年来投资规模较大。同时，行业内头部厂商主要围绕重点技术方向和高景气细分领域进行布局，如 AI、高性能计算、新能源汽车等下游应用领域，具体情况如下：

下游公司	固定资产投入相关的公开披露信息
通富微电	通富微电在《通富微电子股份有限公司 2025 年年度报告》中披露：“展望 2026 年，AI 算力需求预计继续扩张，并逐步向更广泛应用场景延伸，包括机器人、自动化、边缘计算及智能制造等领域。先进封装仍将是性能提升的重要路径，随着高带宽内存堆叠数量持续增加、chiplet 架构进一步普及，封装复杂度将持续提升……为实现上述经营目标，并为今后的生产经营做好准备，公司及下属控制企业南通通富、通富通科、合肥通富、厦门通富、通富超威苏州及通富超威槟城等计划 2026 年在设施建设、生产设备、IT、技术研发等方面投资共计 91 亿元。”
长电科技	长电科技在《长电科技 2026 年 1-3 月投资者关系活动记录表》中披露：“关于下一步扩产规划，公司将基于对市场的研判继续聚焦高端产能布局并围绕以下几方面展开：一是应用领域倾斜，结合未来市场预判，保持向汽车电子、运算存储、高密度电源等领域适度侧重；二是深化客户合作，始终重视客户关系，持续强化与头部高端客户的绑定；三是加大研发投入，聚焦先进封装技术及前沿领域的突破，推动技术发展与应用需求深度契合。总体来看，结合当前先进封装的旺盛需求趋势，公司将持续加大相关投资力度。”在《长电科技 2026 年 4-6 月投资者关系活动记录表》中披露：“2026 年固定资产投资预算约 100 亿元，较去年预算大幅增加，彰显了公司坚定把握半导体行业战略性机遇的决心和执行力。”

下游公司	固定资产投入相关的公开披露信息
华天科技	华天科技在《关于对外投资设立全资子公司的公告》中披露：“为了在集成电路先进封装市场竞争中抢抓先机，公司拟设立华天先进，华天先进以 2.5D/3D 等先进封装测试为主营业务。该公司设立后，将进一步加大 2.5D/3D 等先进封装测试业务领域的投入，加快推动先进封装业务的发展。”在《关于控股子公司项目投资公告》中披露：“同意控股子公司华天科技（南京）有限公司（以下简称“华天南京”）投资 30 亿元进行“华天南京集成电路先进封装测试产业基地二期二阶段建设项目”的建设。”
伟测科技	伟测科技在《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》中披露：“本次募集资金拟投资项目包括“伟测科技上海总部基地项目”及“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”，主要用于扩大公司集成电路测试产能，尤其是 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能。”
甬矽电子	甬矽电子在《甬矽电子投资者关系活动记录表（编号：2026-001）》中披露：“2026 年资本开支规模预计较 2025 年有所增长，主要投向包括现有产品线产能扩张、新客户产品导入、晶圆级封装及 2.5D、FC 类产品等领域。”在《关于对外投资暨签署投资协议书的公告》中披露：“公司拟在中意宁波生态园投资建设“微电子高端集成电路 IC 封装测试三期项目”……。本项目计划总投资金额 103 亿元，包含土地出让金、厂房建设及设备购置费等。”

报告期内，公司经营情况良好，且公司客户储备资源丰富。截至 2026 年 7 月末，公司在手订单为 2.87 亿元。公司在手订单充足，为公司未来业绩的实现和增长提供了有力的订单保障。

3、主要型号平均单价、成本费用情况

报告期内，公司测试分选机设备收入按不同的产品型号可以进一步划分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列等。报告期内，因客户采购的具体型号结构及配置不同等因素影响，公司测试分选机的平均单价及平均单位成本，稍有上升，总体较为稳定。

（1）公司主要型号产品平均单价、单位成本及毛利率情况

报告期内，因客户采购的具体型号结构及配置不同等因素影响，公司测试分选机的平均单价、单位成本及毛利率，稍有上升，总体较为稳定。

（2）高附加值产品销量占比提升，推动公司收入及利润快速增长

报告期内，公司测试分选机设备收入按不同的产品型号具体收入构成如下：

单位：万元

业务类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
EXCEED-6000 系列	8,538.42	14.26%	9,135.04	13.12%	6,181.02	15.33%	7,510.95	21.67%
EXCEED-8000 系列	23,938.28	39.99%	23,903.24	34.34%	13,761.06	34.14%	17,119.10	49.38%

业务类别	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
EXCEED-9000 系列	15,600.61	26.06%	27,211.45	39.10%	10,493.90	26.03%	4,364.84	12.59%
其他设备	6,815.39	11.38%	3,035.26	4.36%	4,818.39	11.95%	2,296.50	6.62%
合计	54,892.70	91.70%	63,284.98	90.92%	35,254.38	87.46%	31,291.39	90.26%

注：EXCEED-9000 系列收入统计包括 EXCEED-9032 系列、EXCEED-9800 系列等产品。

由上表可知，报告期内，EXCEED-9000 系列、EXCEED-8000 系列等高附加值产品收入占比不断提升，推动公司收入及利润快速增长。

（3）规模效应带来的期间费用率摊薄，有效优化成本费用结构，推动净利润提升

报告期内，公司的期间费用率和净利率情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	金额	金额	变动率	金额	变动率	金额
营业收入	60,071.36	69,817.60	71.68%	40,666.63	17.12%	34,723.45
期间费用	10,141.58	14,611.55	39.14%	10,501.53	21.61%	8,635.44
期间费用率	16.88%	20.93%	-4.89%	25.82%	0.95%	24.87%
净利润	17,117.46	17,652.53	124.93%	7,848.15	-7.44%	8,479.41
净利率	28.50%	25.28%	5.99%	19.30%	-5.12%	24.42%

注：此处期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用，未包含财务费用。

报告期内，在公司营业收入大幅增长带来的规模效应下，公司期间费用率整体呈现下降，从 2023 年的 24.87%下降至 2026 年 1-6 月的 16.88%，主要系公司报告期内业绩持续增长，收入的规模效应带来的期间费用率摊薄，有效优化了公司的成本费用结构，推动净利润提升。

（二）与可比公司变动趋势是否存在较大差异

报告期内，公司与同行业可比公司营业收入、毛利率、净利润的比较情况如下：

项目	公司	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入（万元）	华峰测控	73,846.52	134,641.06	90,534.54	69,086.19
	长川科技	346,078.98	529,154.21	364,152.60	177,505.49
	金海通	60,071.36	69,817.60	40,666.63	34,723.45
毛利率	华峰测控	74.70%	73.79%	73.31%	71.19%
	长川科技	55.48%	55.05%	54.85%	56.67%

项目	公司	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
	金海通	53.55%	52.21%	47.46%	47.55%
净利润（万元）	华峰测控	41,461.36	53,609.61	33,391.49	25,165.23
	长川科技	96,274.56	134,362.11	46,698.15	6,065.91
	金海通	17,117.46	17,652.53	7,848.15	8,479.41

报告期内，公司和可比公司的营业收入与净利润，均呈现高速增长趋势，整体变动趋势保持一致，公司和可比公司毛利率均呈现整体稳定增长的趋势，变动趋势不存在较大差异。

（三）业绩增长是否具有可持续性

如前文所述，从公司产品情况看，公司产品需求旺盛，公司产品管线丰富，形成了完整的产品矩阵，可以应对下游客户的各类需求。报告期内各产品的收入和销量均保持高速增长，毛利率、单价均整体稳定且维持在较高水平。

从下游客户资本开支看，在 AI 算力与先进封装技术快速发展的双重驱动下，下游客户持续进行资本投入，市场需求旺盛，公司在手订单充沛，可以为公司未来业绩提供坚实的基础。

从可比公司情况来看，公司与可比公司均保持着高速的业绩增长趋势，符合行业发展规律。

综上，公司业绩增长具有可持续性。

（四）公司是否能够持续满足可转债相关发行条件

根据《上市公司证券发行注册管理办法》规定，主板上市公司向不特定对象发行可转债需满足最近三个会计年度盈利，且最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于 6%（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。

2023 年度、2024 年度及 2025 年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 6,946.60 万元、6,773.65 万元和 17,104.86 万元，公司最近三个会计年度盈利。

2023 年度、2024 年度及 2025 年度，公司扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为 5.60%、5.18%和 11.84%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均为 7.54%，不低于百分之六。公司符合《上市公司证券发行注

册管理办法》的规定。

2026 年 1-6 月，公司实现的归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为 16,855.31 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低）为 9.78%，全年预计加权平均净资产收益率仍能高于 6%，2024 年至 2026 年的加权平均净资产收益率预计平均不低于 6%，且预计 2026 年归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低）为正，能够持续满足可转债相关发行条件。

本次可转换债券拟募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数），参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，公司预计能够持续满足可转债相关发行条件。

综上，公司预计能够持续满足可转债相关发行条件。

二、公司报告期内海外业务的经营情况及主要客户合作情况、境内外业务毛利率的差异原因，报关数据、出口退税金额、信保数据等与公司外销业务规模是否匹配；近期国际贸易政策和税收政策变动是否影响已取得或预计取得的海外订单，相关风险提示是否充分；

（一）公司报告期内海外业务的经营情况及主要客户合作情况、境内外业务毛利率的差异原因，报关数据、出口退税金额、信保数据等与公司外销业务规模是否匹配；

1、公司报告期内海外业务的经营情况

报告期内，公司主营业务收入按境内外区域构成情况如下：

单位：万元

区域	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
内销	43,108.53	72.01%	61,008.99	87.65%	36,500.01	90.55%	28,341.29	81.75%
外销	16,755.04	27.99%	8,593.14	12.35%	3,808.68	9.45%	6,325.93	18.25%
合计	59,863.57	100.00%	69,602.13	100.00%	40,308.69	100.00%	34,667.22	100.00%

报告期内，公司在境外主要国家和地区的收入实现情况如下：

单位：万元

地区	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
马来西亚	12,988.58	77.52%	4,925.20	57.32%	2,625.61	68.94%	2,913.32	46.05%
泰国	1,513.82	9.04%	2,512.83	29.24%	111.78	2.93%	1,200.06	18.97%
新加坡	1,014.23	6.05%	365.38	4.25%	312.03	8.19%	2,063.08	32.61%
其他	1,238.41	7.39%	789.73	9.19%	759.26	19.93%	149.47	2.36%
合计	16,755.04	100.00%	8,593.14	100.00%	3,808.68	100.00%	6,325.93	100.00%

由上表可见，公司境外收入主要来源于马来西亚、泰国、新加坡等地区。为贴近东南亚市场客户并提升服务响应速度，发行人于 2025 年上半年正式启用马来西亚生产运营中心，有效提升了海外市场的订单响应速度与服务敏捷度，成为 2025 年以来境外收入大幅增长的重要支撑。

2、主要境外客户合作情况

公司主要境外客户集中度较高，从 2023 年至 2026 年上半年占境外收入比重均超过 60%，主要客户为全球知名的半导体封装测试企业，且集中在马来西亚、泰国、新加坡等东南亚地区。

3、境内外业务毛利率的差异原因

报告期内，公司境内外业务毛利率情况如下：

类别	项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
境内	销售收入（万元）	43,108.53	61,008.99	36,500.01	28,341.29
	毛利率	50.95%	51.63%	45.74%	45.36%
境外	销售收入（万元）	16,755.04	8,593.14	3,808.68	6,325.93
	毛利率	60.14%	55.48%	60.82%	57.03%
境内外毛利率差异		-9.19%	-3.86%	-15.08%	-11.67%

报告期内公司内销毛利率分别为 45.36%、45.74%、51.63%和 50.95%。报告期内公司外销毛利率分别为 57.03%、60.82%、55.48%和 60.14%。

报告期内，公司内外销毛利率存在一定差异，主要受 EXCEED 系列分选机产品结构变化、功能配置变化等因素影响。一方面，公司境外销售以毛利率较高的 EXCEED-8000 系列为主，拉高了境外收入的综合毛利率；另一方面，境外客户普遍系国际半导体巨头企业，对产品的技术要求较高，产品配置较高，因此毛利率也相对较高。

4、报关数据、出口退税金额、信保数据等与公司外销业务规模是否匹配；

(1) 报关数据与外销收入匹配

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
境外销售收入	16,755.04	8,593.14	3,808.68	6,325.93
减：境外子公司无需报关收入	2,606.55	286.17	-	-
减：调整汇兑差异、无需报关收入	-	3.81	-10.78	17.39
减：上期出口本期确认收入	2,655.31	214.38	93.80	1,497.33
加：本期出口下期确认收入	1,389.60	2,460.87	662.63	-
调整后境外销售收入	12,882.79	10,549.65	4,388.29	4,811.21
海关报关金额	12,882.79	10,549.65	4,388.29	4,811.21
差异金额	-	-	-	-
差异率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

报告期各期，公司境外销售收入与海关报关数据相匹配，具有合理性。具体来看，公司海关出口数据与外销收入形成差异的主要原因系：海关出口数据以货物报关出口日期为准，与公司外销确认收入时点存在时间差异；海关出口数据以美元离岸价等原币计价，根据平均汇率折算后与外销收入按照即时汇率折算存在少量差异等导致。

(2) 出口退税金额

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
境外销售收入（A）	16,755.04	8,593.14	3,808.68	6,325.93
海关报关金额（B）	12,882.79	10,549.65	4,388.29	4,811.21
应退税金额（C）=（B）*出口退税率 13%	1,674.76	1,371.45	570.48	625.46
已出口退税金额（D）	299.61	-	258.19	729.71
退税差异金额（E）=（C）-（D）	1,375.15	1,371.45	312.29	-104.25

报告期内，已出口退税金额与应退税金额存在差异，主要系时间性差异所致。申请出口退税需要单证齐备，受单证传递时效性与税务机关审核等因素影响，出口退税申报时间与收入确认时点相比存在一定差异。因此，公司收入确认时点与出口退税金额确认时点存在时间性差异，具备合理性。

(3) 信保数据

报告期内，发行人未购买中国出口信用保险公司的出口信用保险，此保险不属于境外销售业务中的强制险种，发行人与境外主要客户业务合作关系稳定，境外主要客户综合信誉较好，资金实力较强，具有较好的信用和回款能力，历史上未发生过大额坏账损失，因此发行人基于成本效益原则未购买出口信用保险，符合企业经营实际，具有商业合理性。

（二）近期国际贸易政策和税收政策变动是否影响已取得或预计取得的海外订单，相关风险提示是否充分；

公司海外业务主要聚焦马来西亚、新加坡、泰国等东南亚地区市场，该等地区与中国的贸易关系总体稳定，半导体设备进口关税水平较低。截至本回复出具日，国际贸易政策变动对公司已取得及预计取得的海外订单未产生重大不利影响。

公司出口的核心产品为集成电路行业中封装测试用的测试分选机，报告期内，公司外销主要面向东南亚市场。对于已取得在手订单，相关价格条款已在合同中锁定，短期内关税波动不会直接影响公司既定订单的交付与收入确认。公司不存在被境外国家列入出口管制实体清单的情况，亦不存在大量海外订单取消、主要境外客户转移采购的情形。

综上，近期国际贸易政策和税收政策的变动对公司已取得或预计取得的海外订单未产生重大不利影响。

公司已在募集说明书“第三节 风险因素”中针对国际贸易环境等不利因素进行了风险提示，相关风险提示充分：

“

（三）国际贸易摩擦加剧的风险

近年来，国际贸易摩擦持续受到关注，若未来该等国际贸易摩擦进一步升级或境外客户所在地的贸易政策发生重大变化，将可能对公司未来销售及进口原材料的采购造成一定的负面影响，进而对公司的生产和经营业绩带来不利影响。

”

三、报告期公司前五大客户销售占比较高、对关联方销售金额上升的原因及合理性，相关交易定价的公允性；

（一）报告期公司前五大客户占比较高的原因及合理性

2023 年度、2024 年度及 2025 年度，发行人及可比公司前五大客户收入占比情况如下：

前五大客户收入占比	2025 年	2024 年	2023 年
华峰测控	40.12%	33.50%	21.82%
长川科技	57.66%	62.07%	51.34%
金海通	58.28%	50.96%	52.59%

公司前五大客户销售占比较高主要原因为：发行人下游客户主要属于半导体封测行业，全球前十大封测厂商占据 80%以上市场份额，下游行业集中度相对较高，导致公司客户集中度占比较高，该现象属于行业惯例。

可比公司前五大客户销售占比普遍较高，其中，华峰测控下游客户有较多芯片设计企业，因产品结构及客户群体差异，前五大客户集中度相对较低。而长川科技与公司客户集中度水平相近，总体来看，前五大客户占比较高的特征符合行业惯例。

（二）报告期对关联方销售金额上升的原因及合理性，相关交易定价的公允性

1、对关联方销售金额上升的原因及合理性

发行人主要客户中，仅有通富微电系发行人关联客户。

通富微电（002156.SZ）系国内封装测试领域龙头企业之一，2025 年收入 279.21 亿元，截至本回复出具日，市值近千亿元。截至报告期末，通富微电控股股东南通华达微电子集团股份有限公司持有发行人 6.2%的股份，超过 5%，系公司的关联方。

一方面，公司系国内测试分选机龙头企业，具有较强的稀缺性，通富微电入股公司可以有效形成产业协同，保障核心设备的稳定供应。另一方面，公司下游主要面向封装测试行业，行业客户集中度高，通富微电作为龙头企业之一，公司与其保持长期稳定的合作关系，具有商业合理性。

通富微电作为全球前十大封装测试企业之一，具有较强的全球市场竞争力。在国内集成电路产业快速发展、封装测试市场需求持续增长的大背景下，通富微

电对公司的测试分选机产品需求快速提升，报告期内，公司向通富微电的销售收入逐年提升。

通富微电根据其自身经营状况、生产需求和发展规划进行设备采购。报告期内，通富微电的营业收入、净利润及固定资产投资情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	1,604,101.99	2,792,142.47	2,388,168.07	2,226,928.32
净利润	177,376.27	137,722.96	79,150.08	21,599.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	519,872.66	621,112.33	455,356.69	512,493.41

注：通富微电相关数据来源于其年度报告及半年度报告。

报告期内，发行人对通富微电的销售金额变化趋势与通富微电的经营状况、固定资产投资规模变动趋势及其自身生产经营计划相符。

综上，鉴于半导体行业整体处于快速增长的发展态势，同时基于通富微电的未来发展及稳步扩产计划，以及发行人优良的产品性能、良好的品牌形象和市场地位，报告期对关联方销售金额上升具备合理性。

2、相关交易定价的公允性

(1) 关联交易定价机制

公司关联交易定价遵循市场化原则，以双方协商确定的价格为基础，参考同类产品向非关联方销售的价格水平，确保定价公允。同时，不同设备机型以及选配件、软件配置的差异，也会导致最终成交价格存在合理浮动。

(2) 关联交易总体情况

公司对通富微电的关联销售主要为公司主要产品测试分选机。公司向通富微电的关联销售在平均单价和毛利率方面总体与非关联客户处于同一区间，不同年份有一定的差异，主要原因系各产品系列占比、产品具体型号、定制化配置等有所差异所致。

例如，发行人会根据客户的不同需求，基于基础机型进行模块和零部件的定制化配置，同一型号的测试分选机因配置不同销售价格也会有所差异。针对同一系列产品，三温机型价格最高，常高温机型价格亦高于常温机型。同时，针对相

同机型产品，测试工位数量越多价格越高。此外，高精度温控系统、测试手臂大压力模块、防静电处理模块、芯片自动旋转系统、高精度视觉定位识别系统等选装配置和功能也会提高整机的销售价格。

综上，公司销售给通富微电的产品整体与非关联客户在价格、毛利率等方面处于同一区间，无重大差异。不同年份存在的差异，主要系各产品系列占比、产品具体型号、定制化配置等引起的。

(3) 关联方与非关联方同系列产品价格对比

整体来看，发行人销售给通富微电的产品价格与销售给其他非关联方客户的产品价格相近，少部分年度存在一定差异，主要为产品型号、配置等因素影响。因此，分系列来看，公司销售给通富微电的产品参照市场公允价格由双方协商确定，定价具有公允性。

四、公司报告期内应收账款规模变动的原因；结合应收账款账龄、下游客户资信状况、预期信用损失情况、期后回款情况、单项计提内容及依据、同行业可比公司坏账计提情况等，说明公司坏账计提是否充分；

(一) 公司报告期内应收账款规模变动的原因；

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款	72,727.66	52,141.01	34,222.55	24,397.52
营业收入	60,071.36	69,817.60	40,666.63	34,723.45
应收账款占营业收入比重	60.53%	74.68%	84.15%	70.26%

注：2026 年 1-6 月比例已经年化处理。

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 24,397.52 万元、34,222.55 万元、52,141.01 万元和 72,727.66 万元，应收账款总体随收入增长而呈上升态势，公司应收账款与营业收入增长总体匹配。2025 年度及 2026 年 1-6 月，随着公司业务规模持续扩大，营业收入增速显著提升，应收账款增长率低于营业收入增长率，回款效率有所改善。

(二) 结合应收账款账龄、下游客户资信状况、预期信用损失情况、期后回款情况、单项计提内容及依据、同行业可比公司坏账计提情况等，说明公司

坏账计提是否充分；

1、应收账款账龄

报告期各期末，发行人应收账款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	66,674.93	83.83%	46,249.50	80.19%	30,857.69	82.81%	22,062.96	83.40%
1-2 年	10,125.59	12.73%	8,550.03	14.82%	5,684.17	15.25%	4,142.32	15.66%
2-3 年	2,463.99	3.10%	2,630.76	4.56%	720.82	1.93%	246.30	0.93%
3-4 年	270.09	0.34%	242.90	0.42%	-	-	3.54	0.01%
4-5 年	-	-	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-	-	-
应收账款 账面余额	79,534.59	100.00%	57,673.18	100.00%	37,262.68	100.00%	26,455.12	100.00%

报告期内，发行人应收账款质量良好，账龄基本在 1 年以内。

2、下游客户资信状况

报告期各期末，公司应收账款前五名客户资信情况如下：

单位：万元

期间	客户名称	应收账款期末余额	占比	客户性质	资信状况
2026 年 6 月 30 日	客户 A	18,511.64	23.27%	上市公司	良好
	客户 D	7,579.40	9.53%	新三板挂牌审核中	良好
	客户 K	4,758.14	5.98%	境外上市公司	良好
	客户 F	4,012.98	5.05%	上市公司	良好
	客户 G	3,976.87	5.00%	上市公司	良好
	合计	38,839.03	48.83%		
2025 年 12 月 31 日	客户 C	11,589.36	20.09%	上市公司	良好
	客户 A	9,492.83	16.46%	上市公司	良好
	客户 F	6,556.52	11.37%	上市公司	良好
	客户 D	5,076.19	8.80%	新三板挂牌审核中	良好
	客户 L	2,377.10	4.12%	集成电路芯片高精度测试加工服务，正常运营	良好

期间	客户名称	应收账款期末余额	占比	客户性质	资信状况
	合计	35,092.00	60.85%		
2024 年 12 月 31 日	客户 A	4,070.71	10.92%	上市公司	良好
	客户 G	3,974.40	10.67%	上市公司	良好
	客户 D	3,918.88	10.52%	新三板挂牌审核中	良好
	客户 C	3,748.83	10.06%	上市公司	良好
	客户 I	1,949.45	5.23%	第三方独立芯片测试运营服务企业，正常运营	良好
	合计	17,662.27	47.40%		
2023 年 12 月 31 日	客户 G	5,504.04	20.81%	上市公司	良好
	客户 D	2,997.46	11.33%	新三板挂牌审核中	良好
	客户 I	2,530.00	9.56%	第三方独立芯片测试运营服务企业，正常运营	良好
	客户 C	2,517.55	9.52%	上市公司	良好
	客户 A	1,546.21	5.84%	上市公司	良好
	合计	15,095.25	57.06%		

公司报告期应收账款前五大客户主要为上市公司或行业知名企业，资信状况良好，经营稳定，未出现重大信用风险事件，不存在经营困难、无法回款等情形。因此发行人应收账款回收风险较小，发行人已经充分计提了相应的坏账准备。

3、预期信用损失情况

(1) 公司坏账计提政策

公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收一般客户货款

应收账款组合 2：应收合并报表范围内关联方货款

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(2) 报告期内公司应收账款坏账计提情况

报告期各期末，公司按照预期信用损失模型计提坏账准备的应收账款及坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	账面余额	占比	坏账准备	占比	计提比例
账龄	2026年6月30日				
1年以内	66,674.93	83.83%	3,333.75	48.98%	5.00%
1-2年	10,125.59	12.73%	2,025.12	29.75%	20.00%
2-3年	2,463.99	3.10%	1,231.99	18.10%	50.00%
3-4年	270.09	0.34%	216.07	3.17%	80.00%
4-5年	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-
合计	79,534.59	100.00%	6,806.93	100.00%	8.56%
账龄	2025年12月31日				
1年以内	46,249.50	80.19%	2,312.47	41.80%	5.00%
1-2年	8,550.03	14.82%	1,710.01	30.91%	20.00%
2-3年	2,630.76	4.56%	1,315.38	23.78%	50.00%
3-4年	242.90	0.42%	194.32	3.51%	80.00%
4-5年	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-
合计	57,673.18	100.00%	5,532.18	100.00%	9.59%
账龄	2024年12月31日				
1年以内	30,857.69	82.81%	1,542.88	50.75%	5.00%
1-2年	5,684.17	15.25%	1,136.83	37.39%	20.00%
2-3年	720.82	1.93%	360.41	11.86%	50.00%
3-4年	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-
合计	37,262.68	100.00%	3,040.13	100.00%	8.16%
账龄	2023年12月31日				
1年以内	22,062.96	83.40%	1,103.15	53.61%	5.00%
1-2年	4,142.32	15.66%	828.46	40.26%	20.00%
2-3年	246.30	0.93%	123.15	5.99%	50.00%
3-4年	3.54	0.01%	2.83	0.14%	80.00%
4-5年	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-
合计	26,455.12	100.00%	2,057.59	100.00%	7.78%

由上表可以看出，公司报告期内应收账款账龄结构总体保持稳定，坏账准备

计提金额随应收账款余额增长而逐年增加。

综上所述，报告期各期末，发行人已按预期信用损失模型充分计提应收账款坏账准备。

4、期后回款情况

截至 2026 年 8 月 18 日，公司应收账款回款情况具体如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款余额	79,534.59	57,673.18	37,262.68	26,455.12
期后回款金额	13,872.55	38,112.51	32,626.35	25,169.82
回款比例	17.44%	66.08%	87.56%	95.14%

截至 2026 年 8 月 18 日，报告期各期末的应收账款期后回款比例分别为 95.14%、87.56%、66.08%和 17.44%。其中，2026 年 6 月 30 日应收账款回款比例为 17.44%，主要系期后回款统计期间较短，客户回款周期尚未届满，具备合理性。整体而言，公司应收账款回款风险较小，期后回款情况良好。

5、单项计提内容及依据

对于存在客观证据表明发生减值的应收账款，公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

报告期各期末，公司不存在以单项计提坏账的应收账款组合。

6、同行业可比公司坏账计提情况

公司名称	项目	2026 年 6 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
华峰测控	单项计提	-	-	-	-
	账龄计提	8.51%	8.84%	11.68%	11.47%
	合计比例	8.51%	8.84%	11.68%	11.47%
长川科技	单项计提	-	-	-	-
	账龄计提	5.43%	5.23%	6.09%	6.04%
	合计比例	5.43%	5.23%	6.09%	6.04%
金海通	单项计提	-	-	-	-
	账龄计提	8.56%	9.59%	8.16%	7.78%
	合计比例	8.56%	9.59%	8.16%	7.78%

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 7.78%、8.16%、9.59% 和 8.56%，与同行业长川科技和华峰测控的计提比例相比处于合理区间，整体计提政策稳健，符合行业惯例。

综上，报告期内公司应收账款账龄主要在 1 年以内，账龄结构合理。公司下游客户资信状况整体较为良好，公司按照《企业会计准则》的相关要求对应收账款预期信用损失进行了合理计量，且应收账款期后回款情况良好。公司应收账款坏账计提政策与同行业可比公司相比较为谨慎，应收账款坏账准备的计提比例与同行业可比公司差异具有合理性，公司应收账款坏账准备计提充分。

五、公司报告期内存货规模变动的原因，长库龄存货的形成原因及订单覆盖情况，试用订单的转化情况，发出商品增长幅度较大的原因及合理性；结合存货库龄、周转率、期后结转情况、减值测试过程、可变现净值确定依据、同行业可比公司情况等，说明公司存货跌价准备计提是否充分；

（一）公司报告期内存货规模变动的原因，长库龄存货的形成原因及订单覆盖情况，试用订单的转化情况，发出商品增长幅度较大的原因及合理性；

1、存货规模变动的原因

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2026.6.30		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
原材料	10,113.92	17.69%	8,609.51	19.98%	5,747.48	18.46%	6,904.85	19.77%
在产品	24,798.39	43.36%	13,516.29	31.37%	13,830.28	44.41%	15,933.34	45.62%
库存商品	8,923.99	15.61%	6,897.69	16.01%	5,261.72	16.90%	6,210.60	17.78%
发出商品	11,170.91	19.53%	12,920.56	29.99%	5,570.53	17.89%	5,059.93	14.49%
委托加工物资	2,179.00	3.81%	1,139.44	2.64%	728.79	2.34%	817.02	2.34%
合计	57,186.20	100.00%	43,083.49	100.00%	31,138.80	100.00%	34,925.74	100.00%

报告期各期末，发行人存货账面余额分别为 34,925.74 万元、31,138.80 万元、43,083.49 万元和 57,186.20 万元。

2024 年末，公司存货规模较 2023 年下降 10.84%，主要系公司加强库存管理、优化库存结构所致。

2025 年末及 2026 年 6 月末，公司存货规模持续增长，主要系公司业务规模扩大、订单增加，为保障交付而主动备货所致。具体体现在原材料、库存商品、发出商品均有所增长，其中 2025 年发出商品增长较快，主要系当年客户订单大幅增加，部分产品已发货但尚未完成验收所致。2026 年 6 月末在产品增幅较大，主要系公司为应对订单增长，增加了生产投入，导致在产品余额显著上升。

2、长库龄存货的形成原因及订单覆盖情况

（1）存货库龄结构

报告期各期，存货的库龄结构情况如下：

单位：万元

截止日	存货余额	库龄 1 年以内	库龄 1 年以上	库龄 1 年以内占比
2026 年 6 月末	57,186.20	48,776.07	8,410.13	85.29%
2025 年末	43,083.49	35,310.95	7,772.54	81.96%
2024 年末	31,138.80	23,783.84	7,354.96	76.38%
2023 年末	34,925.74	26,079.90	8,845.84	74.67%

总体来看，公司存货库龄结构良好。报告期各期末，存货库龄在 1 年以内的占比分别为 74.67%、76.38%、81.96%和 85.29%，占比较高，存货流动性较好。

报告期各期末，库龄 1 年以内的存货占比持续提升，存货结构持续优化；库龄 1 年以上存货金额总体保持稳定，未出现明显积压。

（2）长库龄存货的形成原因

公司长库龄存货占比较少。报告期末，库龄 1 年以上的存货余额仅有 8,410.13 万元，占期末存货余额 57,186.20 万元的比例为 14.71%。具体情况如下：

单位：万元

存货明细	报告期末存货余额	其中，1 年以上库龄	1 年以上库龄占比
原材料	10,113.92	2,748.50	27.18%
在产品	24,798.39	1,908.67	7.70%
库存商品	8,923.99	1,542.02	17.28%
发出商品	11,170.91	2,206.74	19.75%
委托加工物资	2,179.00	4.19	0.19%
合计	57,186.20	8,410.13	14.71%

上述长库龄存货形成的原因主要包括：

A、发出商品主要为已发往客户现场但尚未完成终验收的设备。对于新型号产品或新客户，公司产品在规模量产之前，会经历时间较长的客户验证周期，在

此期间公司会根据客户的需求，对产品方案进行调整改进。因此，发出商品具有明确客户及订单基础，不属于无销售支持的存货。

B、在产品主要为尚未完成整机装配和调试的零部件。部分在产品根据在手订单、生产计划及通用机型需求安排生产，后续受客户定制配置、项目进度及整机排产安排影响，形成 1 年以上库龄。因此，部分在产品存货库龄在 1 年以上具有合理性，存货跌价准备计提充分。

C、库存商品主要为完成生产调试、等待发货的设备，部分库存商品受客户现场条件、发货安排及项目交付进度影响形成 1 年以上库龄。除已单独存放的报废、不良产品外，其他长库龄库存商品具有订单或后续交付安排，不属于无销售基础的积压产品。

D、原材料主要根据在手订单、生产计划、采购周期及安全库存需求采购。部分物料因采购周期较长、通用零部件备货及项目排产安排等形成 1 年以上库龄。除已单独存放并全额计提跌价准备的不良物料外，其他长库龄原材料主要为仍可用于生产、售后服务等的通用物料，具备继续使用价值。

综上所述，公司长库龄存货形成原因均具有合理性。

(3) 长库龄存货订单覆盖情况

报告期内，公司长库龄存货中，发出商品、库存商品及半成品中的机台为主要构成部分。报告期各期末，长库龄机台存货金额其订单覆盖情况如下：

时间	库龄一年以上机台存货金额 (万元)	订单覆盖金额 (万元)	订单覆盖比例(%)
2026 年 6 月末	4,629.81	287.49	6.21%
2025 年末	3,130.60	835.00	26.67%
2024 年末	3,851.89	1,999.79	51.92%
2023 年末	4,555.65	3,984.25	87.46%

注：库龄 1 年以上机台存货，包括半成品、发出商品和库存商品。

公司 2023 年、2024 年形成的长库龄机台设备订单覆盖比例较高，后续覆盖比例逐渐下降主要由于长库龄设备转为正式订单需要较长的调试及客户验证周期。对于长库龄原材料和组件，通用物料继续留用，专用物料逐步处理或报废。

因此，公司长库龄存货订单覆盖情况总体较好，具备商业合理性。

3、试用订单的转化情况

报告期内，发行人为拓展业务及市场，存在基于试用订单（Demo）向客户发货，后期由客户按照使用运行情况转正式销售订单的情况，上述情况属于半导体设备行业的行业惯例，其他半导体设备公司如长川科技、中科飞测、中微公司等均披露过其存在试用订单情况。

例如，中微公司公开资料披露：“根据集成电路设备行业惯例，新客户、成熟客户新工艺的首台设备通常会被客户要求先进行工艺验证试用设备，工艺验证通过后再决定是否采购该设备进而双方签署正式销售合同（以下简称“转单”，即 Demo 订单转正式商业订单），该类型的设备通常会签署 Demo 试用/验证协议。”

具体到半导体测试分选设备行业中，产品前期验证较为关键，下游客户在新设备导入时，首台验证设备因需全面适配客户产线，并在过程中结合工艺进度实时调整，因此会经历较长时间的验证周期，而在通过客户验证达到量产阶段时，设备的成熟度和稳定性已经经历了验证，因此整体验收周期较短。客户通常一旦确定合格设备供应商，轻易不进行更换，后期的持续下单确定性较强，客户粘性较强。

公司在报告期不断推出新产品和迭代产品，不断对产品进行改进升级并不断开拓新客户，因此存在较多的试用订单。发出商品中试用订单分别为 4,778.71 万元、4,496.68 万元、6,418.95 万元和 6,820.00 万元，占发出商品余额比例分别为 94.44%、80.72%、49.68%和 61.05%。

报告期各期末，公司试用订单的实现销售金额分别为 4,030.28 万元、3,574.23 万元、2,269.32 万元和 583.41 万元，占比分别为 84.34%、79.49%、35.35%和 8.55%。其中，2023 年、2024 年，公司试用订单转化率较高，主要系该部分订单经过客户验证，已满足客户需求转换为正式订单。2025 年及 2026 年上半年形成的试用订单转化率较低，主要系期后统计时间较短，客户尚处于调试和验证阶段，预计后续随着验证完成，转化率将逐步提升。

综上，试用订单模式是公司业务拓展的有效手段，具有商业合理性，公司的试用订单转化情况良好。

4、发出商品增长幅度较大的原因及合理性

报告期各期末，发行人发出商品具体如下：

单位：万元

存货类别	2026 年 6 月末		2025 年末		2024 年末		2023 年末
	金额	变动率	金额	变动率	金额	变动率	金额
发出商品	11,170.91	-13.54%	12,920.56	131.94%	5,570.53	10.09%	5,059.93

报告期各期末，发行人发出商品余额分别为 5,059.93 万元、5,570.53 万元、12,920.56 万元和 11,170.91 万元，主要系已向客户发出但尚未验收的测试分选机。随着发行人销售订单的逐步增加，各期末发出商品余额亦相应增长。

报告期内，公司发出商品增长幅度较大的原因及合理性主要为：首先，报告期内，半导体设备行业景气度回升，下游公司订单量显著增加，公司发货量也快速增加；其次，半导体测试分选机为大型专用设备，单台价值量较高，此类设备发往客户现场后，需进一步完成安装调试及验收，存在一定验收周期。

（二）结合存货库龄、周转率、期后结转情况、减值测试过程、可变现净值确定依据、同行业可比公司情况等，说明公司存货跌价准备计提是否充分；

1、存货库龄结构

报告期各期，存货的库龄情况如下：

单位：万元

截止日	存货余额	库龄 1 年以内	库龄 1 年以上	库龄 1 年以内占比
2026 年 6 月末	57,186.20	48,776.07	8,410.13	85.29%
2025 年末	43,083.49	35,310.95	7,772.54	81.96%
2024 年末	31,138.80	23,783.84	7,354.96	76.38%
2023 年末	34,925.74	26,079.90	8,845.84	74.67%

报告期各期末，存货库龄在 1 年以内的占比分别为 74.67%、76.38%、81.96% 和 85.29%，库龄 1 年以内的存货占比持续提升，存货结构持续优化；库龄 1 年以上存货金额总体保持稳定，未出现明显积压。总体来看，公司存货库龄结构以 1 年以内为主，流动性较好。

2、存货周转率

报告期内，公司存货周转率分别为 0.59 次/年、0.68 次/年、0.95 次/年及 1.15

次/年。公司根据销售及生产情况合理控制存货水平，存货周转情况较好。报告期内，公司存货周转率显著提升，主要系公司业务规模扩大，同时合理控制存货规模，整体运营效率提升所致。

报告期内，发行人存货周转率与同行业可比公司对比情况如下：

可比上市公司	存货周转率（次）			
	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
华峰测控（688200.SH）	0.98	1.46	1.50	1.15
长川科技（300604.SZ）	0.74	0.82	0.74	0.40
发行人	1.15	0.95	0.68	0.59

注：可比公司数据来源于 WIND，2026 年 1-6 月数据已经年化处理。

由上表可知，报告期内，公司存货周转率与可比公司范围接近，整体不存在较大差异。

3、期后结转情况

截至 2026 年 7 月末，发行人存货期后结转比例如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
期后结转金额	16,541.53	27,350.05	23,943.27	29,828.09
存货余额	57,186.20	43,083.49	31,138.80	34,925.74
期后结转比例	28.93%	63.48%	76.89%	85.40%

截至 2026 年 7 月 31 日，公司报告期各期末存货期后结转率分别为 85.40%、76.89%、63.48%和 28.93%，其中，2026 年 6 月末存货期后结转率稍低，主要因为期后时间较短。因此，公司存货期后整体结转比例较高，不存在显著库存积压情形或迹象。

4、减值测试过程与可变现净值确定依据

公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营

过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

综上，发行人减值测试过程完整，可变现净值确定依据合理、充分。

5、存货跌价准备计提比例与同行业可比公司对比情况

报告期各期末，公司存货跌价准备计提金额和计提比例如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
存货跌价准备 计提金额	1,794.68	1,819.43	1,852.50	1,503.61
存货余额	57,186.20	43,083.49	31,138.80	34,925.74
存货跌价计提 比例	3.14%	4.22%	5.95%	4.31%

与同行业可比公司相比，公司存货跌价准备计提比例对比情况如下：

公司名称	2026 年 6 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
华峰测控	0.98%	1.81%	2.27%	2.24%
长川科技	5.51%	5.80%	5.95%	4.67%
金海通	3.14%	4.22%	5.95%	4.31%

由上表可看出，公司存货跌价准备计提比例高于华峰测控，稍低于长川科技，处于合理范围内。

综上所述，发行人存货库龄以 1 年以内为主，存货周转率处于同行业可比公司区间内，属于合理范围内，存货期后结转比例较高，减值测试过程完整，可变现净值确定依据合理、充分且存货跌价准备整体计提比例高于同行业平均水平。因此，公司存货跌价准备计提充分。

六、公司报告期内外协加工的业务模式及开展情况，相关外协费用与公司对应产品销量或收入的匹配情况；列示报告期内前五大外协供应商的名称、采购金额、合作起始年限等，说明相关方是否与公司存在关联关系或其他利益安排。

（一）公司报告期内外协加工的业务模式及开展情况，相关外协费用与公司对应产品销量或收入的匹配情况；

1、外协加工的业务模式及开展情况

公司的外协加工主要包括机台委外组装、零部件外协加工两种模式。

机台委外组装的业务模式为：公司将部分基础机型机台委托主要外协厂商按照发行人提供的生产图纸进行生产组装，主要可以解决公司在下游客户快速增长的需求背景下遇到的自身产能受限问题。公司负责提供核心模块、整体技术方案及严格的质量检验标准，委外组装厂商则严格按照公司的技术要求和工艺规范，负责完成指定工序的组装和生产。对于生产组装所需的材料，基础原材料、标准零部件由外协厂商按照发行人指定的供应商或品牌直接采购，核心部件如真空吸头装置、浮动机构等由发行人自行采购原材料提供给外协厂商。外协厂商完成组装后，由发行人进行高精度温控系统、高精度视觉定位识别系统等定制功能的安装、软件安装及最终整机调试。

零部件外协加工的业务模式为：外协加工商按照公司对原材料、生产工艺、技术参数、质量标准等的要求进行部分零部件的加工及组装。公司主要外协加工的环节包括 PCB 线路板焊接、喷涂刻字镀膜等机械零件表面处理、加热模块等模块的涂胶组装等。

公司委托供应商进行外协加工的工序均不涉及核心生产环节，且均不是核心

业务，上述外协供应商可替代性强，公司对上述外协供应商及外协加工工序不构成依赖。

2、相关外协费用与公司对应产品销量或收入的匹配情况

报告期内，公司外协加工费用及对应产品收入的匹配情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
机台委外组装	3,270.12	3,113.14	1,320.96	2,763.56
零部件外协加工	55.54	49.15	47.66	64.77
外协费用合计	3,325.66	3,162.30	1,368.62	2,828.33
主营业务收入-测试分选机	54,892.70	63,284.98	35,254.38	31,291.39
占比	6.06%	5.00%	3.88%	9.04%

报告期内，公司外协费用占与公司测试分选机收入的比例分别为 9.04%、3.88%、5.00%和 6.06%，总体处于合理范围，具备匹配性。该增长主要系公司业务规模扩大及产能瓶颈共同作用的结果。在自有产能无法短期内大幅扩充的背景下，外协加工成为保障营收增长的重要手段，外协费用的增长具有充分的合理性。

相关外协台数与公司对应产品销量的匹配情况如下：

单位：台

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
委外组装数量	544	438	179	313
销量	468	539	333	317

由上表可看出，报告期内，公司通过外协完成的委外组装数量与公司销量基本匹配。其中，2025 年度、2026 年 1-6 月公司委外组装数量随着销量增加而快速上升。2026 年 1-6 月委外组装数量高于销量，主要系期末存在较多已完成组装，但尚未完成定制功能的安装、软件安装及最终整机调试等核心工序的设备，上述核心工序由发行人自主完成，受产能制约，尚未完工并销售。

近年来，受下游客户需求快速增长驱动，公司订单量持续攀升。然而，公司目前实际产能主要依托上海租赁厂区，该厂区年产能仅为 360 台，产能已严重受限。为及时响应市场需求、保障订单按期交付，公司通过加大对部分基础款机型的委外组装力度，有效弥补了自有产能的缺口。

综上，报告期内公司外协加工业务模式清晰、管理规范，外协工序不涉及公

司核心技术。受下游需求快速增长及公司现有产能严重受限的影响，公司加大基础款机型委外组装具有充分的必要性与合理性。报告期内，公司外协费用与测试分选机收入相匹配，随业务规模上升而逐渐上升，变动趋势合理，符合公司实际经营情况。

（二）列示报告期内前五大外协供应商的名称、采购金额、合作起始年限等，说明相关方是否与公司存在关联关系或其他利益安排。

报告期内，公司前五大外协供应商情况如下：

年份	序号	供应商名称	外协费用 金额（万元）	占比	采购内容	合作起始年限
2026 年 1-6 月	1	供应商 A	1,865.59	56.10%	机台委外加工费	2021 年
	2	供应商 B	759.07	22.82%	机台委外加工费	2022 年
	3	供应商 C	645.46	19.41%	机台委外加工费	2025 年
	4	供应商 J	33.16	1.00%	零部件外协加工	2023 年
	5	供应商 K	7.20	0.22%	零部件外协加工	2018 年
	合计		3,310.48	99.54%		
2025 年 度	1	供应商 A	2,332.93	73.77%	机台委外加工费	2021 年
	2	供应商 B	270.90	8.57%	机台委外加工费	2022 年
	3	供应商 M	267.23	8.45%	机台委外加工费	2024 年
	4	供应商 C	242.08	7.66%	机台委外加工费	2025 年
	5	供应商 N	12.97	0.41%	零部件外协加工	2019 年
	合计		3,126.11	98.86%		
2024 年 度	1	供应商 A	1,305.96	95.42%	机台委外加工费	2021 年
	2	供应商 M	15.00	1.10%	零部件外协加工	2024 年
	3	供应商 N	13.94	1.02%	零部件外协加工	2019 年
	4	供应商 O	11.36	0.83%	零部件外协加工	2017 年
	5	供应商 P	7.44	0.54%	零部件外协加工	2019 年
	合计		1,353.70	98.91%		
2023 年 度	1	供应商 H	1,626.54	57.51%	机台委外加工费	2021 年
	2	供应商 A	1,137.02	40.20%	机台委外加工费	2021 年
	3	供应商 Q	20.57	0.73%	零部件外协加工	2017 年
	4	供应商 N	12.49	0.44%	零部件外协加工	2019 年
	5	供应商 P	7.20	0.25%	零部件外协加工	2019 年
	合计		2,803.82	99.13%		

上述主要外协供应商与公司均不存在关联关系或其他利益安排。

报告期内，公司机台外协加工供应商较为集中，2025 年、2026 年 1-6 月，

公司外协采购规模显著提升，主要系公司业务规模扩大、产品结构升级所致。

【核查程序及核查意见】

一、核查程序

针对问题（1），申报会计师执行了以下核查程序：

1、访谈公司管理层了解各型号产品功能差异及供需情况，获取公司在手订单情况；查阅下游客户定期报告等公开文件，了解下游客户资本开支计划；获取并复核分产品型号的收入、成本及毛利率明细表，分析各产品型号收入、毛利率变动的原因及合理性；查阅发行人报告期各期财务报告及审计报告，复核营业收入、净利润、毛利率的变动情况；

2、查阅同行业可比公司定期报告等公开文件，对比分析发行人营业收入、毛利率、净利润变动趋势与同行业是否存在较大差异及原因；

3、访谈发行人管理层，了解行业发展趋势，评价公司业绩增长是否具有可持续性；

4、复核发行人报告期各期扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润、加权平均净资产收益率的计算过程，测算最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）的平均值；结合本次募集资金规模及近期债券市场发行利率水平，测算发行人最近三年平均可分配利润对本次债券一年利息的覆盖情况；复核本次发行后累计债券余额占净资产的比例，核查发行人是否符合相关规定，能否持续满足向不特定对象发行可转换公司债券的相关条件。

针对问题（2），申报会计师执行了以下核查程序：

1、获取发行人报告期各期境外销售收入明细表，分析境外收入变动原因；根据公开资料查询境外客户主要情况，复核境内外业务毛利率，分析差异原因及合理性；

2、获取发行人报告期内报关单、免抵退税申报表等，核对境外销售收入与海关报关金额、出口退税金额，分析差异原因及合理性，验证境外销售收入的真实性和准确性；

3、了解近期国际贸易政策和税收政策变动情况，评估对已取得或预计取得

的海外订单的影响。

针对问题（3），申报会计师执行了以下核查程序：

1、查阅同行业可比公司年度报告，了解行业市场集中度及同行业可比公司客户集中度情况，分析公司客户集中度较高的原因；获取报告期各期前五大客户名单及销售明细，分析客户构成变动原因及合理性。

2、与发行人管理层访谈，了解关联交易定价机制；获取关联方分型号收入成本及毛利率明细表，对比关联方与非关联方同类产品的销售价格及毛利率，分析关联交易定价的公允性。

针对问题（4），申报会计师执行了以下核查程序：

1、获取报告期各期末应收账款明细及账龄表，分析应收账款规模变动原因及与收入增长的匹配性；

2、通过公开信息查阅报告期内主要客户基本情况及资信状况，分析是否存在回款风险较高的客户；

3、查阅同行业上市公司公开披露资料，与发行人应收账款账龄结构、坏账准备计提比例进行对比分析；

4、获取应收账款期后回款情况，选取回款金额较大的客户获取收款银行回单，检查期后回款是否真实、准确；

5、了解和评价公司与应收账款预期信用损失相关的内部控制设计和运行有效性，复核应收账款坏账准备的计提金额，核实计提的准确性及充分性。

针对问题（5），申报会计师执行了以下核查程序：

1、获取报告期内公司存货明细表，分析存货规模变动的合理性；针对长库龄存货，访谈发行人管理层，了解并分析长库龄存货的形成原因；获取试用订单期后转化表，核实试用订单的期后转化情况；获取报告期内公司发出商品明细表，分析发出商品增长幅度较大的原因及合理性；

2、实施存货监盘程序，核实存货的存在性和完整性；

3、获取存货跌价准备计算表，检查公司对存货跌价准备的计提方法是否与

会计政策一致，复核可变现净值的确定依据及计算过程，评价其合理性；结合库龄分析及期后销售情况，以及同行业可比公司的存货跌价计提比例，评估存货跌价准备计提是否充分。

针对问题（6），申报会计师执行了以下核查程序：

1、访谈公司生产部门及采购部门负责人，了解外协加工的业务模式、外协环节和产品范围；查阅公司与主要外协供应商签订的合同；

2、获取公司报告期各期外协采购明细表，核实外协加工费用金额及占比，复核外协费用与公司对应产品销量及收入的匹配情况；

3、取得外协供应商采购台账，获取前五大外协供应商的工商登记信息，核查主要外协供应商与公司是否存在关联关系及其他利益安排。

二、核查意见

经核查，申报会计师认为：

1、报告期内，公司营业收入、毛利率、净利润变动原因与公司实际情况相符，具有合理性，与可比公司变动趋势不存在重大差异；公司业绩增长具有可持续性。发行人最近三个会计年度连续盈利，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低者计）平均不低于 6%，最近三年平均可分配利润足以支付本次债券一年的利息，发行人预计能够持续满足向不特定对象发行可转换公司债券的相关条件；

2、公司报告期内境外收入真实，境内外毛利率存在差异，主要系产品结构差异和境外客户议价能力的影响，差异原因合理；报关数据、出口退税金额等与外销业务规模相匹配；公司主要出口国家/地区的贸易政策总体稳定，近期国际贸易政策和税收政策总体稳定，不会影响公司已取得或预计取得的海外订单，公司已在募集说明书中对相关风险进行了充分风险提示；

3、报告期内，公司前五大客户销售占比较高，与下游行业集中度较高的特征相符，与同行业可比公司的前五大客户销售占比水平总体保持一致，具有商业合理性；报告期内，公司对关联方销售金额的上升，与客户的业务快速发展及设备采购需求变化相匹配。公司关联交易定价遵循市场化原则，交易定价具备公允

性；

4、报告期内，公司应收账款账龄主要在 1 年以内，账龄结构合理。公司下游客户资信状况整体较为良好，公司按照《企业会计准则》的相关要求对应收账款预期信用损失进行了合理计量，且应收账款期后回款情况良好。公司应收账款坏账计提政策与同行业可比公司相比较为谨慎，应收账款坏账准备的计提比例与同行业可比公司差异具有合理性，公司应收账款坏账准备计提充分；

5、报告期内，公司存货规模变动具有合理原因，长库龄存货主要为试用订单待客户验收及备用件等，形成原因具备合理性，订单覆盖情况良好，试用订单转化情况整体较好。发出商品的增长与销售规模扩大和客户验收周期等特点相匹配，期后验收及收入确认情况良好。发行人存货库龄以 1 年以内为主，存货周转率处于同行业可比公司区间内，属于合理范围内，存货期后结转比例较高，减值测试过程完整，可变现净值确定依据合理、充分且存货跌价准备整体计提比例高于同行业平均水平。因此，公司存货跌价准备计提充分；

6、报告期内，公司的外协加工主要包括机台委外组装、零部件外协加工两种模式，相关外协费用与公司对应产品销量及收入相匹配，主要外协供应商与公司不存在关联关系或其他利益安排。

问题 3.关于其它

请发行人说明：

（1）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的和拟投入的财务性投资情况；结合投资标的与公司业务的协同性，分析公司是否满足最近一期末不存在金额较大财务性投资的要求。

请保荐机构及申报会计师根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第 1 条、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》第 1 条进行核查并发表明确意见。

（2）实际控制人及其近亲属控制企业的具体情况，结合瑞跃鼎峰的历史沿革、资产、人员、技术、主营业务等方面与发行人的关系，以及业务是否具有替代性、竞争性，是否有利益冲突，销售渠道、主要客户及供应商是否重叠等情况，说明相关方在公司首发上市后成立瑞跃鼎峰的背景及主要考虑，瑞跃鼎峰与发行人是否构成同业竞争，本次募投项目实施后是否新增构成重大不利影响的同业竞争。

请保荐机构及发行人律师结合《监管规则适用指引—发行类第 6 号》第 1 条对进行核查并发表明确意见。

【发行人说明】

一、本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的和拟投入的财务性投资情况；结合投资标的与公司业务的协同性，分析公司是否满足最近一期末不存在金额较大财务性投资的要求；

（一）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入的和拟投入的财务性投资情况

2026 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。本次董事会决议日前六个月（2025 年 10 月 31 日）至本回复出具日，公司对有为图像技术（苏州）有限公司（以下简称“有为图像”）进行了股权投资，具体投资时间、持股比例、被投对象的业务、与公司业务的相关性和协同性、公司可获取的资源情况如下：

序号	公司名称	账面价值	投资时间	被投资公司主营业务	与公司主营业务的关系及公司可获取的资源	是否认定为财务性投资
1	有为图像技术（苏州）有限公司	1,500.00万元	2026年8月投资1,500万元	有为图像主营半导体后道量检测设备，核心技术集中在光学成像、图像算法、3D检测、运动控制、自动上下料及检测软件系统方向。	有为图像主要产品主要系面向先进封装领域的量检测设备，与公司同处半导体后道“检测+测试”设备环节，面向相同的客户群体。公司投资有为图像，可以在技术交流、市场拓展、客户资源等方面产生协同，增强公司产品竞争力和客户粘性。	否

根据《证券期货法律适用意见第18号》规定：“围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。”

公司与有为图像具有较强的协同效应，属于以获取技术、渠道为目的的产业投资，且符合公司主营业务及战略发展，因此，对有为图像不属于财务性投资。

除上述情况，自本次发行相关董事会决议日前六个月起本回复出具日，公司不存在实施或拟实施的其他投资情况。

（二）结合投资标的与公司业务的协同性，分析公司是否满足最近一期末不存在金额较大财务性投资的要求

截至2026年6月30日，公司可能涉及财务性投资且余额不为零的相关会计科目及财务性投资金额汇总情况如下：

单位：万元

序号	项目	账面价值	其中：财务性投资
1	货币资金	33,081.35	-
2	交易性金融资产	12,269.59	-
3	其他应收款	1,043.94	-
4	其他流动资产	4,212.14	-
5	长期股权投资	3,010.92	-
6	其他权益工具投资	1,000.00	-
7	其他非流动金融资产	4,999.44	-
合计		59,617.38	-

（1）货币资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司货币资金主要由银行存款、现金及其他货币资金构成，不属于财务性投资。

(2) 交易性金融资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产余额为 12,269.59 万元，主要由理财产品构成。公司购买的理财产品主要为挂钩汇率的金融衍生品及固定收益类产品，风险等级均为 R1-R2，不属于收益风险波动大且风险较高的金融产品，不构成财务性投资。

(3) 其他应收款

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他应收款为 1,043.94 万元，主要为保证金、备用金、往来款等，不属于财务性投资。

(4) 其他流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他流动资产为 4,212.14 万元，主要系预交所得税、待认证进项税及未交增值税，不属于财务性投资，具体如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	
	金额	占比
预缴企业所得税	5.05	0.12%
增值税借方余额重分类	4,131.43	98.08%
其他待摊费用	75.66	1.80%
其他流动资产合计	4,212.14	100.00%

(5) 长期股权投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司长期股权投资为 3,010.92 万元，其中投资成本 3,000.00 万元，损益调整为 10.92 万元，系投资深圳市华芯智能装备有限公司，具体投资时间、持股比例、被投对象的业务、与公司业务的相关性和协同性、公司可获取的资源情况如下：

序号	公司名称	账面价值	投资时间	被投资公司主营业务	与公司主营业务的关系及公司可获取的资源	是否认定为财务性投资
1	深圳市华芯智能装备有限公司	3,010.92 万元	2024 年 3 月投资 2,000 万元, 2024 年 7 月投资 1,000 万元, 距本次发行董事会决议日已超过六个月	半导体晶圆级分选封测和平板级封装贴晶机设备及方案提供商	华芯智能主营晶圆级分选机 Wafer to tape & reel (晶圆到卷带)、IGBT KGD (已知良好芯片) 分选机, 属于晶圆级测试分选设备领域, 公司所在的 FT (Final Test) 属于封装后成品测试, 公司投资华芯智能, 有利于公司了解并积极探索前道晶圆级测试分选相关细分领域, 助力公司未来拓宽产品布局, 增强竞争力。	否

上述被投资单位均从事实业经营, 符合公司主营业务及战略发展方向, 该等投资系围绕公司产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资, 不构成财务性投资。

(6) 其他权益工具投资

截至 2026 年 6 月 30 日, 公司其他权益工具投资为 1,000.00 万元, 具体投资时间、被投对象的业务、与公司业务的相关性和协同性、公司可获取的资源情况如下:

序号	公司名称	账面价值	投资时间	被投资公司主营业务	与公司主营业务的关系及公司可获取的资源	是否认定为财务性投资
1	芯诣电子科技(嘉兴)有限公司	500.00 万元	2024 年 10 月, 距本次发行董事会决议日已超过六个月	芯片动态老化测试设备以及解决方案的提供商	芯诣电子主营芯片动态老化测试设备以及解决方案的提供商。先进封装测试领域, 特别是系统级测试领域中, 越来越多的厂家把功能测试及老化测试合并同步测试, SLT (系统级测试)+burnin (老化测试) 一体化测试是公司产品研发方向之一。投资芯诣电子有助于公司进行技术储备及相关产品研发, 进一步增强竞争优势。	否
2	鑫益邦半导体(江苏)有限公司	500.00 万元	2024 年 12 月, 距本次发行董事会决议日已超过六个月	芯片贴片机及相关服务提供商	在当下 AI 芯片架构领域, HBM 存储速度和能力是制约芯片性能的非常关键的要素, 同时存储领域是公司长期关注并重点布局的赛道。投资鑫益邦有助于公司从前道贴片机设备角度了解 HBM 及存储芯片前道工艺流程, 有助于公司进行技术储备及布局	否

上述被投资单位均从事实业经营, 符合公司主营业务及战略发展方向, 该等

投资系 围绕公司产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，不构成财务性投资。

(7) 其他非流动金融资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产为 4,999.44 万元，具体投资时间、被投对象的业务、与公司业务的相关性和协同性、公司可获取的资源情况如下：

序号	公司名称	账面价值	投资时间	被投资公司主营业务	与公司主营业务的关系及公司可获取的资源	是否认定为财务性投资
1	苏州猎奇智能设备股份有限公司	1,999.44 万元	2024 年 8 月，距本次发行董事会决议日已超过六个月	光通信和半导体设备提供商，主要提供固晶机、耦合设备、测试设备等光通信和半导体设备	未来，AI 相关芯片会进入光电共封的发展阶段，结合公司目前已有的热管理相关技术，公司需要继续发展光电同测技术，苏州猎奇处于光模块领域前沿，公司通过本次投资有助于公司发展电测和光测同测相关技术方向，有助于公司进行电测和光测同测相关技术储备。	否
2	瑞玛思特（无锡）测控科技有限公司	3,000.00 万元	2025 年 4 月，距本次发行董事会决议日已超过六个月	射频测试仪器、射频测试机及板卡、云平台提供商	根据公司目前业务规划，需要进一步增强公司产品测试分选机在通讯类和车载雷达芯片领域的竞争力，瑞玛思特产品为射频测试仪器、射频测试机及板卡及相关云平台，随着智能网联汽车的发展，未来车内通讯模块及雷达测试需求将大幅增长，通过投资瑞玛思特，公司可以进一步了解此类芯片测试特性和对测试环境的精密要求，有助于公司进一步测试分选机在测试分选此类芯片的性能及竞争优势。	否

综上，截至最近一期末，公司不存在财务性投资，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》中对“最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的要求，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资的情形。

【核查程序及核查意见】

一、核查程序

针对上述事项，申报会计师执行了以下核查程序：

(1) 取得货币资金明细表、银行账户明细及开户清单，查看银行账户性质；核查理财产品明细情况；

（2）获取其他应收款、其他流动资产明细，检查款项性质；

（3）查询发行人公告，了解长期股权投资、其他权益工具投资中被投资企业的注册地、成立时间、经营范围等基本情况，与发行人确认上述股权投资是否存在业务协同等；获取上述投资交易文件，检查股权交易情况；查阅上述股权投资相关协议，了解协议内容、投资方式；

（4）访谈发行人管理层，获取并查阅发行人出具的相关说明，了解本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前是否存在财务性投资、最近一期末是否存在金额较大的财务性投资。

二、核查意见

经核查，申报会计师认为：

自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司未实施或拟实施财务性投资；截至最近一期末，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资的情形。

（此页无正文，为天津金海通半导体设备股份有限公司容诚专字
[2026]361Z0644号报告之签字盖章页。）



中国注册会计师: 蔡如笑 
蔡如笑（项目合伙人）

中国注册会计师: 詹湛湛 
詹湛湛

中国·北京

2026 年 9 月 8 日